

关于合肥市建设投资控股(集团)有限公司 2025 年非公开科技创新债第二期专项用于三地一区建设示范引领及存储半导体挂牌的公告

上证公告(债券)(2025) 26973 号

依据《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等规定,本所同意合肥市建设投资控股(集团)有限公司 2025 年非公开科技创新债第二期专项用于三地一区建设示范引领及存储半导体于 2025 年 10 月 30 日起在本所挂牌,并采取点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式。该债券证券简称为“25 合投 K2”,证券代码为“280464”。

其它具体条款内容见债券募集说明书或发行公告。债券在本所挂牌,不表明本所对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及债券的投资风险或者收益等作出判断或保证。债券投资的风险,由投资者自行承担。

上海证券交易所

2025 年 10 月 28 日